



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 密封圈 > 模压 EMI 垫片导电片



密封圈类型: 模制 EMI 密封圈

成品类型: 导电薄板

粘合材料: 硅胶

填充材料: 镀镍石墨（镍/碳）

密封圈形状: 矩形

[所有 模压 EMI 垫片导电片 \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

成品类型	导电薄板
粘合材料	硅胶
填充材料	镀镍石墨（镍/碳）
闭合力	151.4 N/cm²

电气特征

耐石油	否
体积电阻率（最大值）	.05 Ω.cm

主体特性

密封圈类型	模制 EMI 密封圈
密封圈形状	矩形

尺寸

产品厚度	1.6 mm[.062 in]
------	-----------------



产品宽度	50 mm[1.968 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 160 °C[-67 – 320 °F]

产品合规性

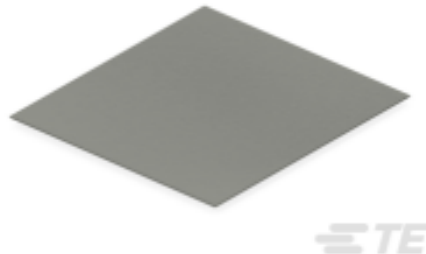
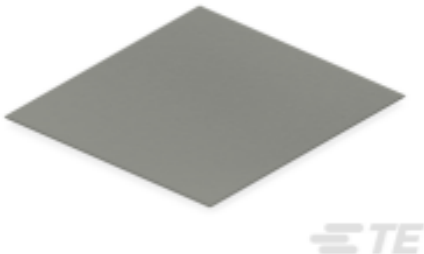
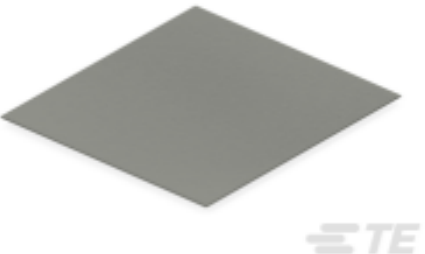
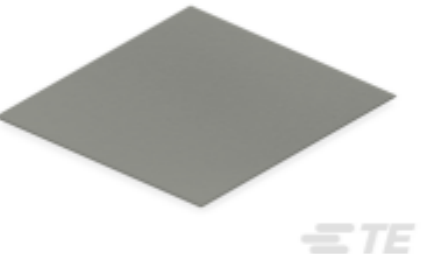
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： DCP (.22% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

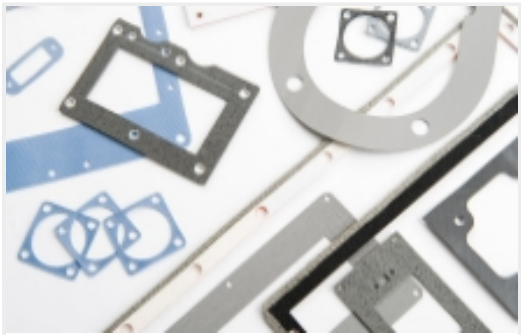
配套部件

 TE 产品编号 2452698-1 SNA-C Sheet 300mm sq x 1.6mm	 TE 产品编号 2452652-1 SNA Sheet 300mm sq x 1.6mm	 TE 产品编号 CAT-EMIG-0003 模压 EMI 垫片导电片	 TE 产品编号 2452662-1 SNA Sheet 50mm sq x 1.6mm sample
--	--	--	--

该系列中的其他产品 | [Kemtron 1210 系列](#)



EMI 密封圈(36)



医用 EMI 垫片(36)

文档

[SNG Sheet 50mm sq x 1.6mm sample](#)

英文版本

数据表/目录页

[Performance Materials brochure](#)

英文版本

[Datasheet - Conductive Elastomers](#)

英文版本

应用规格

英文版本